



中华人民共和国国家标准

GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005
代替 GB/T 7333—1996

电子设备用固定电容器 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质 直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—
Part 2-1: Blank detail specification—
Fixed metallized polyethylene-terephthalate film—
Dielectric d. c. capacitors—Assessment levels E and EZ

(IEC 60384-2-1:2005, IDT)

2012-11-05 发布

2013-02-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电 子 设 备 用 固 定 电 容 器
第 2-1 部 分：空 白 详 细 规 范
金 属 化 聚 乙 烯 对 苯 二 甲 酸 酯 膜 介 质
直 流 固 定 电 容 器 评 定 水 平 E 和 EZ
GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 街 甲 2 号 (100013)
北 京 市 西 城 区 三 里 河 北 街 16 号 (100045)

网 址：www.gb168.cn

服 务 热 线：010-68522006

2013 年 2 月 第 一 版

*

书 号：155066·1-46138

版 权 专 有 侵 权 必 究

前 言

GB/T 7333—2012 按照 GB/T 1.1—2009 和 GB/T 20000.2—2009 给出的规则起草。

《电子设备用固定电容器》系列国家标准分为如下若干部分：

- 第 1 部分：总规范(GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999)；
- 第 2 部分：分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005)；
- 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005)；
- 第 3 部分：分规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器(IEC 60384-3:2007)
- 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ (IEC 60384-3-1:2007)
- 第 4 部分：分规范 固体和非固体电解质铝电解电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998,第 1 号修改单:2000)
- 第 4-1 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电解电容器 评定水平 EZ(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4:2000)；
- 第 4-2 部分：空白详细规范 固体(MnO₂)电解质的铝电解固定电容器. 评定水平 EZ (IEC 60384-4-2:2007)
- 第 6 部分：分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(IEC 60384-6:2005)；
- 第 6-1 部分：空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(IEC 60384-6-1:2005)；
- 第 7 部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185—2012)；
- 第 7-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E (GB/T 10186—2012)；
- 第 8 部分：分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005)；
- 第 8-1 部分：空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2012/IEC 60384-8-1:2005)；
- 第 9 部分：分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005)；
- 第 9-1 部分：空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5969—2012/IEC 60384-9-1:2005)；
- 第 11 部分：分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 (IEC 60384-11:2008)；
- 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 (IEC 60384-11-1:2008)；
- 第 12 部分：分规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 10679—1995/IEC 60384-12:1988)；
- 第 12-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E (GB/T 10680—1995/IEC 60384-12-1:1988)；
- 第 13 部分：分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-13:2006)；
- 第 13-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E (IEC 60384-13-1:2006)；

- 第 14 部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 14472—1998/IEC 60384-14:1993,第 1 号修改单:1995);
- 第 14-1 部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 14473—1998/IEC 60384-14-1:1993);
- 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽固定电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982,第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992);
- 第 15-1 部分:空白详细规范 固体电解质钽箔固定电容器 评定水平 E(GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
- 第 15-2 部分:空白详细规范 固体电解质烧结钽固定电容器 评定水平 E(GB/T 12795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
- 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽固定电容器 评定水平 E(GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-3:1984);
- 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(GB/T 10190—2010/IEC 60384-16:2005);
- 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005);
- 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器(IEC 60384-17:2005);
- 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-17-1:2005);
- 第 18 部分:分规范 表面安装固体和非固体电解质铝电解固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
- 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 17207—2012/IEC 60384-18-1:2007);
- 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝电解质固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
- 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-19:2006);
- 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(IEC 60384-19-1:2006);
- 第 21 部分:分规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
- 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
- 第 22 部分:分规范 表面安装多层 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
- 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004)。

本部分为电子设备用固定电容器系列国家标准的第 2-1 部分。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 60384-2-1:2005《电子设备用固定电容器 第 2-1 部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

- GB/T 2693—2001 电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范(idt IEC 60384-1:1999);
- GB/T 7332—2011 电子设备用固定电容器 第 2 部分:分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯

膜介质直流固定电容器(IEC 60384-2:2005, IDT)

本部分做了下列编辑性修改:

- 删除了 IEC 前言;
- 删除了第 1 页“序言”两字;
- 本标准一词改为本部分;
- A0 分组中的 4.3.2、4.3.3、4.3.1、4.3.4、4.3.3.2、4.3.4.2 英文有误, 变更为 4.2.2、4.2.3、4.2.1、4.2.4、4.2.3.2、4.2.4.2。

本部分代替 GB/T 7333—1996。本部分与 GB/T 7333—1996 相比, 主要变化如下:

- 增加了金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器评定水平 EZ;
- 增加了 A0 检验分组; 评定水平 E 的 A1 分组的检查水平“S-4”, A2 分组的检查水平“II”均调整为“S-3”。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本部分主要起草单位: 鹤壁市华中科技电子有限责任公司。

本部分主要起草人: 李素兰、宁小波、张素霞、樊金河、李瑞菊。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 7333—1987;
- GB/T 7333—1996。

电子设备用固定电容器
第 2-1 部分:空白详细规范
金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质
直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ

空白详细规范

空白详细规范是分规范的一种补充性文件,它包括了详细规范的格式、编排和最低限度的内容要求。不遵守这些要求的详细规范,认为是不符合电子元件质量评定体系要求的规范。

制定详细规范时应考虑分规范中 1.4 的内容。

首页方括号中数字标注的位置上应填写下列相应内容:

详细规范的识别

[1] 授权起草本详细规范的组织:IEC 或国家标准机构。

[2] IEC 或国家的详细规范标准编号,发布日期以及国家体制需要的其他内容。

[3] IEC 或国家的总规范编号及其版本号。

[4] IEC 或国家标准的空白详细规范编号。

电容器的识别

[5] 该型号电容器的简述。

[6] 典型结构的简述(适用时)。

注:当电容器不是设计用于印制电路板时,在详细规范的这个位置上应该明确地加以说明。

[7] 对于影响互换性的主要尺寸的外形图,和(或)引用的国家文件或国际文件。也可以在详细规范的附录中给出此图。

[8] 用途或所涉及的应用类别和/或评定水平。

注:详细规范中采用的一个评定水平或若干个评定水平,应从分规范 3.5.4 中选取。这意味着如果试验的分组不变,几个评定水平可共用一个空白详细规范。

[9] 最重要特性的参考数据,以便在各种类型的电容器之间进行比较。